

高精度覆晶热压键合设备

随着半导体行业快速向小型化和高精度发展，Toray Engineering提供独特和领先技术的解决方案，产品阵容包括于 TSV 3D贴装、FOWLP、光学设备和其他用途的各种键合机，并专注于处理 3D封装的各种程序中堆叠应用，如用于 CUF、NCP、NCF、Cu Pillars、TSV芯片堆叠等各种制程。



FC3000L2
Chip On Substrate



FC3000WL
Chip On Wafer

产品特征

- 可处理6~12英寸晶圆(FC3000W系列) 或 95x250mm 基板(FC3000L系列)
- 独特的陶瓷加热器，加热稳定
- 压力和位置的控制压力和高度曲线设置
- 高精度定位和高刚性框架，能够实现高精度定位
- 凭借其独特的间隙控制功能，能够实现最合适的高度控制
- 可更换低压或高压之压合机构，以适用于不同产品设计

产品优势

- 1.5 μm (3σ) 高精度定位
- 快速升温加热器 (200°C/sec @ $\square 22\text{mm}$)
- 压合高度可控制，适用 C4 及 Cu pillar 制程
- 最高 490N 压合力，适用高密度多引脚芯片

